

Express5800/R120h-1M(2nd-Gen)スペック詳細

2019年11月26日版

フレームモデル

商品名称			Express5800/R120h-1M		
モデル名			8x 2.5型ドライブモデル	4x3.5型ドライブモデル	
製品型名			N8100-2773Y	N8100-2774Y	
CPU	Processor		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 150W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 140W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)		
		標準搭載数 / 最大搭載数	0/2		
		コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)		
		インテル® 64	対応		
		インテル® ハイパーセイゼーション・テクノロジー	対応		
		インテル® ハイパースレッシング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204は除く)		
		CPUソケット形状	LGA3647		
		ホットプラグ	-		
		冷却方式	-		
		チップセット		ファンレスヒートシンク インテル® C621 チップセット	
		メモリ		搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)
メモリスロット数	24				
増設単位	1				
搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB) DDR2-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512)GB				
最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)				
メモリアクセス方式	23.4GB/s				
読み出し/書き込み	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)				
メモリスベアリング	ECC, wt SDDC				
メモリモデリング	対応				
ホットプラグ	-				
モジュールピン数	288 ピン				
動作電圧	1.2V				
バッファ機能	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 2x2.5型増設ドライブ(オプション)	
			リア		
		内蔵標準	内部	1x2.5型ドライブ(オプション) 2x M.2 SATAスロット (オプション)	
			内蔵最大	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 21.12TB (11x1.92TB) (オプションHDDケース追加時)	
		ホットスワップ	対応		
		インタフェース規格とRAID構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
		光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1 オプション: Flash FDD (1.44MB) *2		
		FDD			
		拡張ベイ			
		拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (IOMカード専用) (オプションのライザードを予配することとPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。) PCI Express 1.1, 2.0, 3.0	
			規格		
		グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB	
グラフィック表示と解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200				
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)(N811-17-03 内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時) 2x USB3.0 (TypeA), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA A.3.0 オンボード 1x Broadcom® BCM5719 対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います) 対応 (Linuxの対応状況は、NECホームページのLinuxドライバ情報をご参照ください) PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	リア				
ネットワーク	内部	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA A.3.0			
	実装形式	オンボード			
コントローラ	チームング	1x Broadcom® BCM5719			
	FEC / GEC	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)			
ジャンボフレーム	PXE / iSCSI ブート	対応 (Linuxの対応状況は、NECホームページのLinuxドライバ情報をご参照ください) PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応			
	リモート				
マネージメント	マネージメント用ポート	BMC Marvell PHY			
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	キーボード / マウス	対応			
BIOS Version (出荷当初)		オプション System ROM U32 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください) 01.40 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)			
BMC Firmware Revision (出荷当初)		S0, S5			
System Sleep State		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長電源		対応 (標準, ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ可)			
筐体デザイン		対応 (標準, ホットプラグ可)			
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5型ドライブモデル: フロントベゼルレール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5型ドライブモデル: フロントベゼルレール/突起物含まず)			
質量 (最小 / 最大)		14kg / 28kg (ケーブルアーム無し : 22kg) 14kg / 29kg (ケーブルアーム無し : 25kg)			
電源		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大: 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10			
		消費電力(100V最大構成時, 最大電力)	908VA / 899W (800W電源最大値) *7		
		消費電力(200V最大構成時, 最大電力)	1075VA / 1072W *7		
		発熱量	4241KJ/h 3860KJ/h		
		省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率	対象外		
		音量	35.9dBA / 45.1dBA		
		温度条件	ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床土: 1.5m, サーバ台との距離: 1m), サーバ設置(床土: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: 30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)		
		湿度条件	VCCI クラス A		
		ハードウェア認証規定	Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware		
		OS認証	スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル		
		主な添付品	3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業日対応, 祝日の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年ハード保証		
		無償保証内容			
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.6以降 *5, Vmware ESXi™ 6.5 Update2, Vmware ESXi™ 6.7 Update2			
サポートOS	NECサポート	最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います			
動作確認OS *6					

ExpressSelectionPack

製品名称		ExpressSelectionPack	
モデル名		8x 2.5型ドライブモデル	
製品型名		N8100-2774Y	
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)	
		標準搭載数 / 最大搭載数	
		コントローラ・バスとの接続	
		インテル® 64	
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジ	
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ	
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ	
		CPUソケット形状	
		ホットプラグ	
		冷却方式	
チップセット	ファンなしヒートシンク インテル® C621 チップセット 標準搭載なし(セレクトアルオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)		
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	24	
	メモリソケット数	1	
	増設単位	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (64/128GB) DDRT-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512)GB	
	搭載メモリ	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)	
	最大動作周波数	19.2GB/s	
	メモリバス帯域(チャネルあたり)	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)	
	メモリアクセス方式	ECC, x4 SDDC	
	誤り検出・訂正	対応	
	メモリスベリング	対応	
	メモリミラーリング	対応	
ホットプラグ	-		
モジュールピン数	288 ピン		
動作電圧	1.2V		
バックアップ機能	対応		
ドライブ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 2x2.5型増設ドライブ(オプション)
		リア	1x2.5型ドライブ(オプション) 2x M.2 SATAスロット (オプション)
	内蔵標準	-	
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 22TB (11x 2TB), SAS 26.4TB (11x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 42.24TB (11x 3.84TB), SAS SSD: 21.12TB (11x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)
	ホットスワップ	対応	
	インタフェース規格とRAID構成	SATA 6Gbit/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gbit/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1 オプション: Flash FDD (1.44MB) *2	
	FDD	-	
	拡張ベイ	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、ハーフレングス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)	
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB	
	グラフィック表示と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200	
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1xUSB2.0(Type A)(N8117-03 内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時) 2x USB3.0 (TypeA), 1x FireWire 4800 (FireWire 800) (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 4x データLANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 (RJ-45))	
	リア	1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0	
ネットワーク	内部	オンボード	
	実装形式	1x Broadcom® BCM5719	
	コントローラ	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)	
	チームング	対応	
	FEC / GEC	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)	
	ジャンボフレーム	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応	
PXE / iSCSI ブート	BMC		
リモート	コントローラ	Marvell PHY	
マネージメント	マネージメント用ポート	オプション	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		System ROM U32 v2.02 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
BIOS Version (出荷当初)		01.40 (最新のリリースはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
BMC Firmware Revision (出荷当初)		S0, S5	
System Sleep State		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長電源		対応 (標準, ホットプラグ可)	
冗長ファン		1Uラックマウント	
筐体デザイン		434.6mm x 707.0mm x 42.9mm (2.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず) 434.6mm x 749.8mm x 42.9mm (3.5型ドライブモデル: フロントベゼル/レール/突起物含まず)	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		14kg / 28kg (ケーブルアーム無し : 22kg)	
質量 (最小 / 最大)		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション)	
電源		別紙参照	
		別紙参照	
		別紙参照	
		対象外	
		対象外	
		対象外	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		35.9dBA / 45.1dBA	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床土: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床土: 0.75m), 環境温度23°C 動作時: 10~35°C(条件付きで5~40°C/45°C対応可) *11, 保管時: -30~60°C 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
廃熱量		VCCIクラス A	
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル	
音重	音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4	3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く) 3年パーツ保証	
測定方式		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
温度条件		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
湿度条件		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
OS認証		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
主な添付品		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
無償保証内容		3年オンライン保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則営業曜日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
インストールOS		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard *8	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter	
動作確認OS *6		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います	

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまでを示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- *2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照下さい
- *4 特定構成(2xCPU/Xeon Gold 5118), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 1xフレキシブルLOM, 標準ファン, 2x800W 電源)での騒音値
- *6 BTOインストール不可, NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- *7 CPU TDPごとの最大電力は8.1.2をご参照ください。
- *8 本製品はお客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。ご購入の際には、事前にお客様より Windows Server 2016のライセンス条項に同意していただく必要があります。詳細は<http://jpn.nec.com/windowsserver/2016/down.html> をご覧ください。
- *10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- *11 40°C/45°C環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「140°C/45°C対応についての注意事項」をご参照ください。